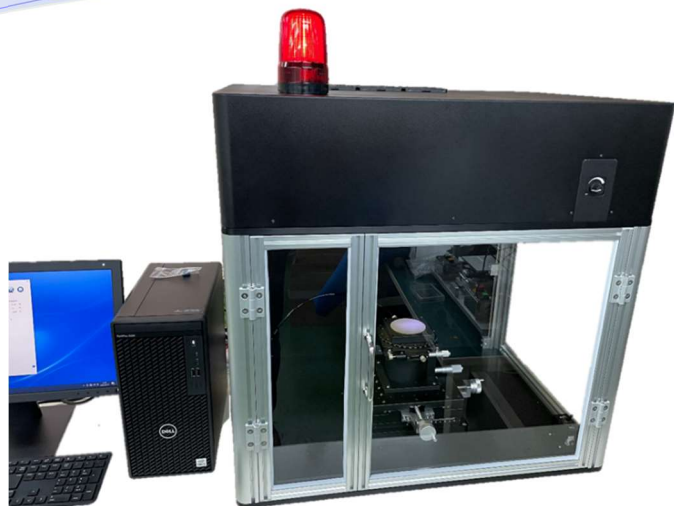


SAMURAI

卓上型 UV レーザー加工システム



- ・ 加工エリア：最大 500mm×500mm
- ・ 出力レンジ：1W ~ 50W をラインナップ
- ・ 非熱加工でダメージレス
- ・ 最小スポット径：φ7μm
- ・ 印字スピード：600cps
- ・ 安全設計されたエンクロージャーシステム
- ・ 用途に合わせてカスタマイズ可能
- ・ ユーザーライクなインターフェース
- ・ 優れたメンテナンス性

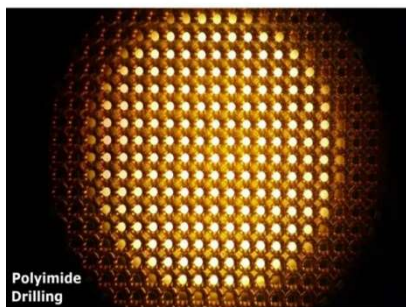
SAMURAI は一体型レーザーシステムでありながら、お客様自身で調整や光学系の交換を行ったりすることができます。また材料や加工内容を変更したい場合など、レーザー光源をより高出力のものに交換することも可能です。不具合時には全システムを交換する必要はなく、該当箇所のみ交換すれば良いというメリットもございます。このため SAMURAI は産業用はもちろんのこと、様々な理化学分野や研究分野でも広く使用されているレーザーシステムです。

【加工例】



Sapphire Scribing

サファイアのスクライビング



Polyimide Drilling

ポリイミドのドリリング



銅箔のカッティング

【印字例】



セラミックス



基板(ポリ塩化ビニル)



キャップ(ポリスチレン)



耐腐食性印字(ステンレス)



レイチャーシステムズ株式会社

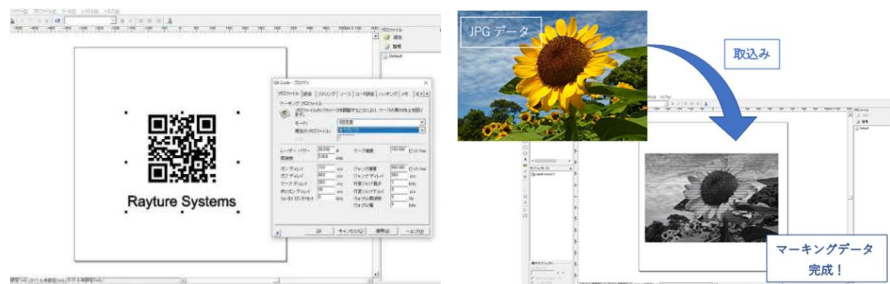
〒160-0006 東京都新宿区舟町7番地 ロクサンビル7F
TEL:03-3351-0717 FAX:03-3351-6771

ウェブサイトは
こちらから



Specifications 仕様

インターフェース



加工やマーキングのパラメータ及びシステム操作の一括制御が可能でレーザー加工に特化したユーザーライクなソフトウェアです。

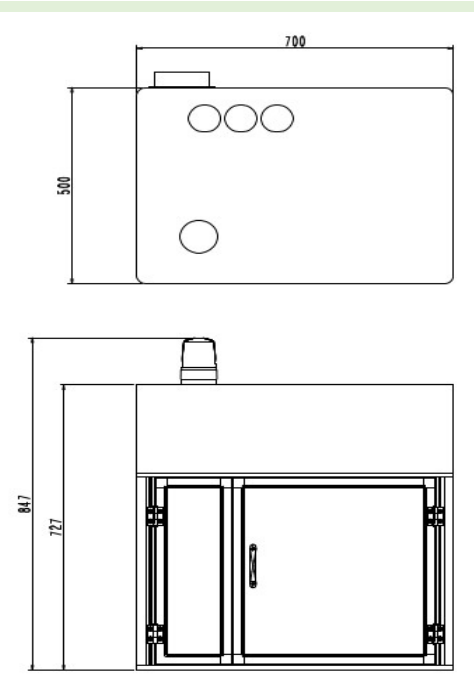
文字印字はもちろん、2次元コードの作成も可能で画像データやCADデータの取り込みも簡単に行えます。

装置仕様

波長	355nm
平均出力	最大 50W (空冷 最大 10W)
パルスエネルギー	最大 1mJ
繰り返し周波数	Single shot ~300kHz
パルス安定性	< 2% RMS
マーキング精度	< 1.5mrad
マーキング再現性	< 22μrad
マーキングスピード	600 cps
最小スポット径	Φ7μm

その他仕様

電圧	AC 100V
環境条件	10~30℃ ただし結露がないこと
ウォーミングアップ時間	15分 (ゼロスタート時は30分)
外寸	W700mm×D500mm×H727mm
重量	50kg
付属品	制御用 PC・ソフトウェア
オプション	同軸カメラ・専用治具、ステージ等



【 外観寸法 】

装置組み込み型タイプ

装置への組み込みを簡易化させる Linear SAMURAI をラインナップしています。新規装置はもちろんのこと、様々な設置環境に対応できますので、既存装置への組み込みも可能です。付属のソフトウェアを使用し素早くジョブの構築が可能です。動いている製品にもマーキングが可能な、MOF(Marking on the Fly)機能も装備しており、様々なシーンでご使用になれます。また高出力レーザーを搭載することで高速生産ラインでのマーキングも可能です。

APIを使用することで、PLC、データベース、ネットワーク、ホストコンピューターなどの生産施設内の他のデバイスとの通信を簡単にカスタマイズできます。



【 Linear SAMURAI 】



レイチャーシステムズ株式会社

〒160-0006 東京都新宿区舟町7番地 ロクサンビル7F
TEL:03-3351-0717 FAX:03-3351-6771

ウェブサイトは
こちらから

